

## 技術詞彙表

本技術詞彙表載有本文件所用與本公司及我們的業務有關的若干技術詞彙解釋。該等詞彙及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法相符。

「AEC-Q100」	指	一種基於失效機制的封裝集成電路應力測試鑒定
「ASIC」	指	特定應用集成電路，一種根據特定應用需求定制的電機控制芯片
「BI系統」	指	商業智能系統，一種決策支持信息管理工具，便於用戶匯總、編目和分析來自組織內外眾多來源的業務數據
「CoWoS」	指	片上基板(Chip-on-Wafer-on-Substrate)，是一種先進的封裝技術，具有封裝尺寸更大、I/O連接更多的優勢
「CPU」	指	中央處理器，一套複雜的電子電路，運行機器的操作系統和應用程序
「DDR」	指	雙倍數據速率，由JEDEC引進的SDRAM產品業界標準
「DIMM」	指	雙列直插式存儲模塊，一種存儲器模塊，其特點是在印刷電路板上安裝一系列DRAM集成電路，兩側都有電氣觸點與設備主板連接，為數據處理提供易失性存儲。DIMM的主要類型包括帶寄存器DIMM(「RDIMM」)、小尺寸DIMM(「SODIMM」)和無緩衝DIMM(「UDIMM」)，每種類型都是為滿足各種計算環境中的特定性能和外形尺寸要求而設計
「DRAM」	指	動態隨機存取存儲器，一種需要定期刷新以保持存儲信息的隨機存取存儲器。由於這種刷新要求，它是一種「動態」或易失性內存，而非易失性或「靜態」存儲器，其在電源關閉時仍能保持內容
「ECC」	指	糾錯碼，一種用於檢測和糾正數據傳輸或存儲中的錯誤的方法
「GB」	指	吉字節，衡量計算機數據存儲容量的標準，大致相當於10億字節
「Gb」	指	吉比特，一種相等於十億比特的數字信息單位
「GDDR」	指	Graphic DDR，一種專門為顯卡而設的高性能DDR記憶體規格

## 技術詞彙表

「GPU」	指	圖形處理單元，一種專門為快速操縱及修改記憶體以加快圖像創建而設的電子電路
「HBM」	指	高寬帶內存，一種用於高性能計算和圖形應用的存儲器，通過先進的封裝技術提供高速數據傳輸速率並增加帶寬
「HSM」	指	混合堆疊內存，本公司目前正在開發的一種存儲器，其目標是在性能方面達到或超過JEDEC HBM標準
「IC」或「集成電路」	指	集成電路，一種微型電子設備或元件，採用半導體技術製造，將電路所需的所有晶體管、電阻器、電容器、電感器及其連接線集成到一個小的半導體晶圓（如硅芯片或基板）上，然後焊接並封裝在外殼內，形成一個具有所需電路功能的電子設備
「IDM」	指	集成設備製造商，指設計、製造和銷售自身產品的公司，負責從設計到製造和分銷的整個生產流程；在半導體行業，指涵蓋整個業務分部的公司，包括芯片設計、晶圓製造和封裝測試
「IEEE」	指	電氣電子工程師學會，世界最大的技術專業人員協會，成立宗旨在於推動科技發展
「物聯網」	指	物聯網，一個通過互聯網相互通信和交換數據的互聯設備網絡
「JEDEC」	指	電子器件工程聯合理事會，固態和半導體行業的標準化機構，負責制定固態電子產品的行業標準
「KGD」	指	已知合格芯片，一種經過廣泛測試的裸芯片或未封裝芯片，經確認具有與封裝產品相同的質量、可靠性和功能，符合規定的功能和規格標準
「大模型」	指	大語言模型，一種在大量文本數據基礎上訓練而成的人工智能模型，可理解和生成人類語言，能夠完成翻譯、總結和問題解答等任務

## 技術詞彙表

「LPDDR」	指	低功耗雙倍數據率，JEDEC推出的低功耗SDRAM產品的行業標準
「Mb」	指	兆比特，一種數字信息單位，約等於一百萬個比特
「MBIST」	指	存儲器內建自測試，這是一種自測試和修復機制，通過一套有效的算法對存儲器進行測試，以檢測典型存儲器單元內可能存在的所有故障
「MHz」	指	兆赫，交流電或電磁波頻率單位，等於一百萬赫茲
「外包半導體封裝和測試公司」	指	外包半導體封裝與測試公司，提供第三方IC封裝與測試服務
「PCB」	指	印刷電路板，在電子學中用於連接電子元件的電路板，使用從層壓在非導電基板上的銅片蝕刻而成的導電路徑、軌道或信號跡線連接電子元件
「RDL」	指	再分佈層，集成電路上的額外金屬層，可在芯片的其他位置提供I/O焊盤，以便在必要時更好地接觸焊盤
「SDR」	指	單倍數據率，由JEDEC引進的SDRAM產品業界標準，每個時脈週期傳輸一次數據
「SDRAM」	指	同步動態隨機存取存儲器，一種使用同步接口的DRAM
「SiP」	指	系統級封裝，一種芯片封裝技術，將多個電子元件（如處理器、存儲器和傳感器）、無源元件和其他電子元件集成到一個封裝中，為緊湊型電子設備提供高集成度、設計靈活性和更小的空間
「SoC」	指	片上系統，一種集成電路，集成了計算機或其他電子系統的大部分或全部組件
「SRAM」	指	靜態隨機存取存儲器，一種使用雙穩態鎖存電路存儲每個位元的隨機存取存儲器，存取速度比DRAM快，且無需定期刷新
「TSV」	指	硅通孔，一種封裝技術，可取代用於連接芯片的傳統導線